

## 第 19 回半導体・センサ パッケージング技術展



2018年1月17日から19日まで東京ビッグサイトで開催される「第19回半導体・センサ パッケージング技術展」に出展します。

ハイパワーデバイス対応ダイボンダー「BESTEM-D340」を世界初出展いたします。

ダイボンダーの分野においてあらゆるニーズにお応えできるラインナップをご用意しております。

また、三次元形状計測装置もパネル出展し、お客様の開発や生産を支えるソリューション提案に繋げる技術や商品のご紹介をさせていただきます。

是非とも当社ブースにお立ち寄りくださいますよう、お願い申し上げます。

開催期間	2018年1月17日(水)～19日(金) 10:00～18:00 (最終日のみ 17:00 まで)	
会場	東京ビッグサイト 東ホール	
当社ブース	No.E25-4	
交通アクセス	<a href="http://www.bigsight.jp/general/access/index.html">http://www.bigsight.jp/general/access/index.html</a>	
出展機種	ハイパワーデバイス対応ダイボンダー <b>BESTEM-D340</b> 	三次元形状計測装置 (パネル・動画) 
本展示会・製品に関するお問い合わせ： キヤノンマシナリー株式会社 セミコンシステム事業本部 営業部 電話番号：077-566-1822 FAX番号：077-566-1833 E-Mail：sales-ml@canon-machinery.co.jp		